

6-104069-2 ✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU System 50

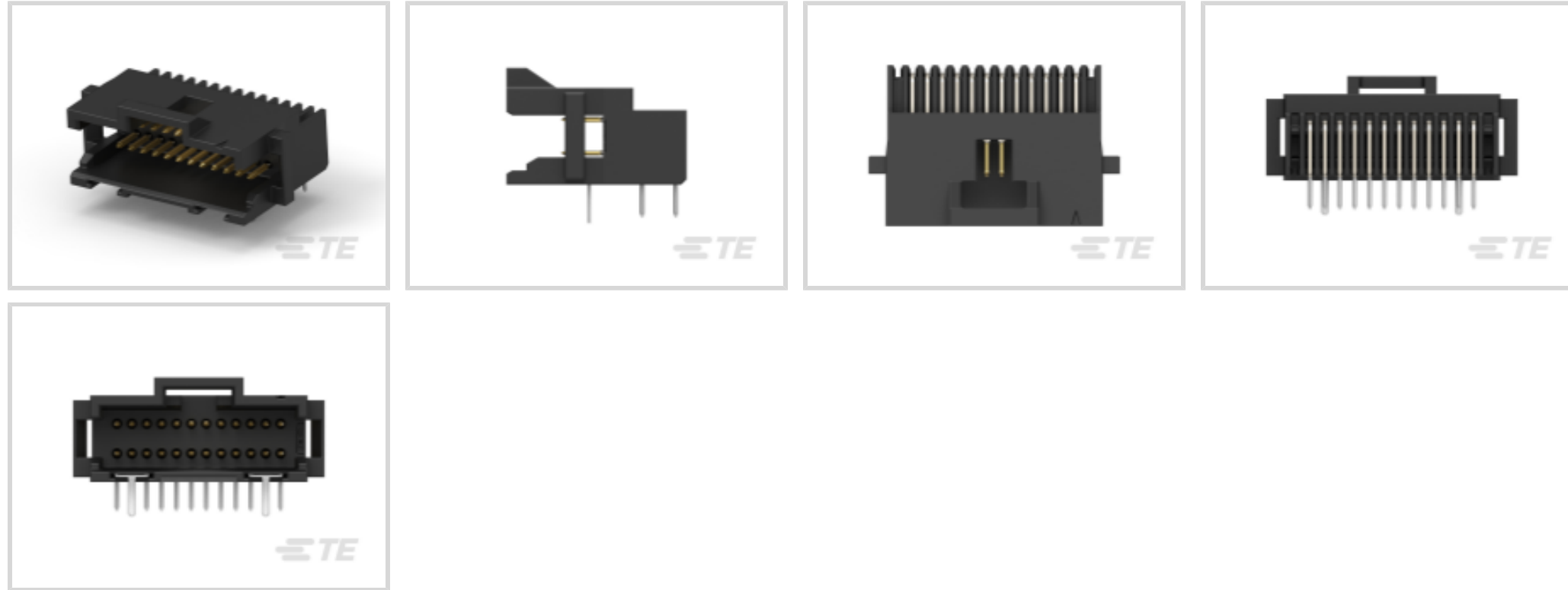
TE 内部编号 6-104069-2

PCB Mount Header, Right Angle, Board-to-Board, 24 Position, 1.27 mm [.05 in] Centerline, Fully Shrouded, Gold, AMPMODU System 50

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: 板对板

位数: 24

行数: 2

中心线 (间距) : 1.27 mm [.05 in]

PCB 安装方向: 直角

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头

结构特性

板对板配置	垂直
连接器端子负载状态	满载
位数	24
行数	2
PCB 安装方向	直角

电气特征

介质耐压 (最大值)	500 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ



工作电压	30 VAC
------	--------

主体特性

连接器外形	标准
-------	----

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

接合方柱尺寸	.38 mm[.015 in]
--------	-----------------

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 – 6.35 μm [150 – 250 μin]
------------------	---

端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm [30 μin]
--------------	--

PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
--------------------	----

端子形状和构造	矩形
---------	----

端子底板材料	镍
--------	---

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
----------------	---

端子基材	铜合金
------	-----

端子接触部电镀材料	金
-----------	---

端子类型	插针
------	----

端子额定电流（最大值）	3.6 A
-------------	-------

端接特性

圆形端接柱体和尾部直径	.38 mm[.015 in]
-------------	-----------------

端接柱体和尾部长度的	2.54 mm[.1 in]
------------	----------------

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

接合对准类型	极化, 极化
--------	--------

接合固定	带有
------	----

PCB 安装固定类型	压具柱体
------------	------

接合固定类型	闭锁
--------	----

连接器安装类型	板安装
---------	-----

接合对准	带有
------	----

PCB 安装对准	不带
----------	----

PCB 安装固定	带有
----------	----

壳体特性

外壳材料	LCP
------	-----

中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
---------	-----------------



尺寸

PCB 厚度 (建议)	1.57 mm [.062 in]
行间距	2.54 mm [.1 in]

使用环境

壳体温度额定值	高
工作温度范围	-65 – 105 °C [-85 – 221 °F]

操作/应用

焊接工艺特性	板支座
电路应用	Signal

行业标准

UL 等级	获得认可
与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	23
封装方法	Box, Tube

其他

已忽略的装载位置	0
----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

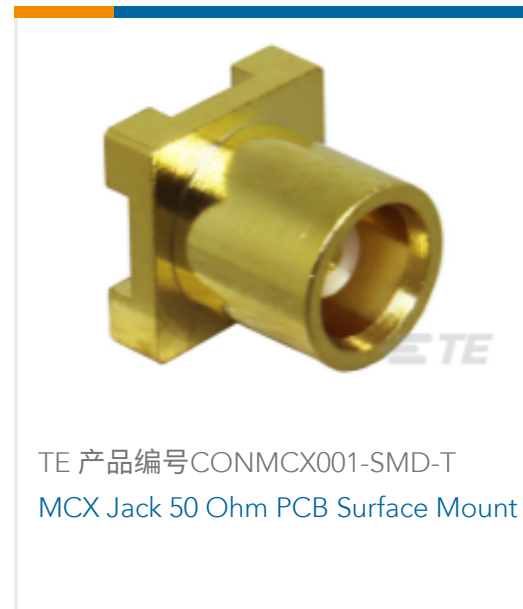
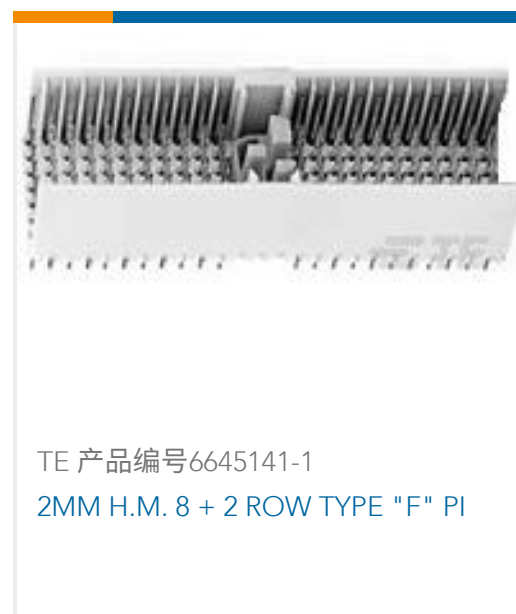
配套部件



该系列中的其他产品 | AMPMODU System 50



客户还购买了



文档

产品图纸

[24 sys 50 hdr drra shrd sn](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_6-104069-2_AA.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_6-104069-2_AA.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_6-104069-2_AA.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页



[AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION3AND4](#)

英文版本

[Ribbon Cable Interconnect Solutions](#)

英文版本

[产品规格](#)

[应用规格](#)

英文版本